



AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 8-146455-3

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 33 Position, 2.54 mm

[.1 in] Centerline, Unshrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal,

AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 33

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	33
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接触部长度	2.79 mm[.109 in]
---------	------------------



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	50 µin
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

堆叠高度	5.08 mm[.2 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖, 拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LE7189, UL E28476
-------------	-----------------------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装方法

Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

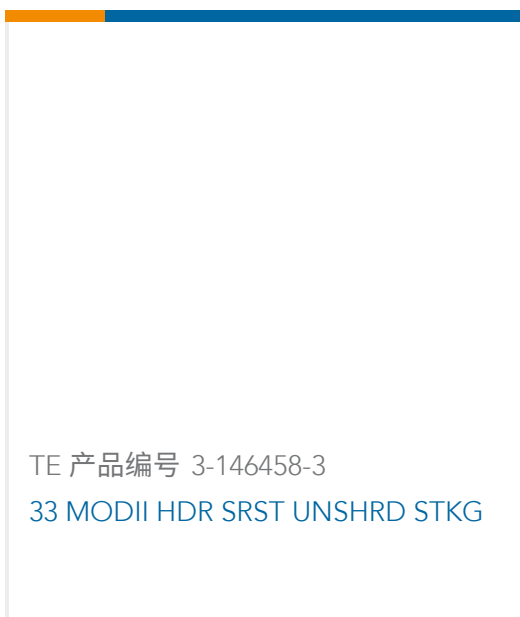
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



客户还购买了





文档

产品图纸

[33 MODII HDR SRST UNSHRD STKG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-146455-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-146455-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-146455-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本